

# سنتر کنترل شده میکروساختارهای دو بعدی منظم در پلاسماهای فعال با چگالی بالا

زهرا مری و غلامرضا فروتن

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

( دریافت مقاله : ۸۹/۳/۸ - پذیرش مقاله : ۹۰/۱/۲۹ )

## چکیده

هدف از این کار، بررسی دینامیک بونها، الکترونها و نانوذرات باردار درون غلاف پلاسمای غباری، به منظور تعیین شرایط مناسب جهت نهشت کنترل شده و گریشی ذرات پلاسما روی سطح یک زیرلایه طرح دار شامل آرایه‌ای ازمیکروساختارهای منظم است. روش مورد استفاده در این مطالعه، شبیه‌سازی عددی معادلات سیالی توصیف کننده دینامیک ذرات پلاسما درون غلاف پلاسمایی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، با افزایش چگالی الکترونی میزان کانونی کنندگی میدان الکتریکی نانوساختارها بیشتر می‌شود، لذا نانوساختارهای با نسبت نمود بالا تولید می‌شود. افزایش دمای الکترونی باعث کاهش بار نانوذرات و در نتیجه کاهش شار آنها بر روی نانوساختار می‌شود. با افزایش چگالی تعداد و عدد ماخ نانوذرات، شار فرودی بر روی نانوساختارها و به تبع آن‌ها افزایش می‌یابد. به علاوه شار فرودی با افزایش ارتفاع و دوره تناوب میکروطرح رشد پیدا می‌کند. از یافته‌های حاضر می‌توان نتیجه گرفت که برای رسیدن به آنگنه نهشت بالا و نانوساختارهایی با نسبت نمود بزرگ، باید از یک پلاسمای چگال با دمای پایین و نانوذرات با سرعت فرودی بالا و میکروطرح با دوره تناوب نسبتاً بزرگ استفاده نمود.

**واژه‌های کلیدی:** غلاف پلاسمایی، نانوذرات غبار، شبیه‌سازی سیالی، نهشت گریشی، نانوتیوب‌های کربنی، پلاسماهای فعال، میکروساختارهای منظم.

## Controlled synthesis of ordered two-dimensional microstructures in reactive high-density plasmas

Z. Marvi and Gh. Foroutan

Department of Physics, Faculty of Science, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

### Abstract

This work's aim is to investigate the dynamics of ions, electrons, and charged nanoparticles inside the dusty plasma sheath, in order to determine the appropriate conditions for the controlled and site selective deposition of plasma particles on a pre-patterned substrate of ordered microstructures. The approach used in this study, is the numerical simulation of the fluid equations, describing the dynamics of plasma particles inside the plasma sheath. The results obtained, show that the focusing effect of the electric field of nanostructures increases with the increasing of the electron number density, leading to the growth of high aspect ratio nanostructures. Increase in the electron temperature, results in the decreasing of the charge of nanoparticles, and consequently in the decreasing of the incident flux on the nanostructures. The enhancement of the number density and Mach number of the nanoparticles, leads to the enhancement of the flux on nanostructures and as a result their growth rate increases. Moreover, the incident flux grows with the increasing of the height and period of micro-pattern. From the present findings it can be concluded that to achieve high deposition rates and nanostructures with a large aspect ratio one should employ a high density, low temperature plasma, large impinging velocity of nanoparticles, and a micro pattern with a relatively large period.

**Keywords:** : Plasma Sheath, Dust Nanoparticles, Fluid Simulation, Site Selective Deposition, Carbon Nanotubes, Active Plasmas, Ordered Microstructures.

E-mail of corresponding author: zmarvi9518@gmail.com

## مقدمه

الکترونی و ساخت نمایشگرها، این ساختارها باید دارای قابلیت‌های ویژه‌ای باشند و باید به صورت عمودی روی زیر لایه‌های جامد رشد داده شوند. نانوتیوب‌هایی که در محیط پلاسمایی کم دما به روش PECVD رشد داده می‌شوند، به طور عمودی روی سطح تراز می‌شوند که عامل آن وجود میدان الکتریکی قائم درون غلاف پلاسمایی است. همچنین روش PECVD به علت امکان کنترل فضایی شار یون‌ها و رادیکال‌ها، فرآیندهای بعد از ساخت همانند لایه نشانی برروی نانوساختارها و اچینگ غیرهمسانگرد آن‌ها را به راحتی امکان‌پذیر می‌سازد. در اینجا ذکر این نکته قابل توجه است که اچینگ غیرهمسانگرد در صنعت میکروالکترونیک است. در چند سال اخیر مطالعات تجربی و عددی متعددی روی تولید و رشد نانوساختارهای کربنی به کمک محیط پلاسمایی انجام شده است [۱۴-۸]. در اغلب کارهای عددی پیشین، اثرات ناشی از بار فضایی نانوذرات، نیروی‌های کششی وارد بر آن‌ها، برخوردهای بین ذرات پلاسمایی با خشی‌ها و یونیزاسیون روی ساختار غلاف بررسی نشده است، [۱۶و۱۵]. در حالی که در بسیاری از شرایط واقعی که چگالی و سرعت یون‌ها در داخل غلاف قابل ملاحظه است نیروی کشش یونی نقش مهمی در دینامیک ذرات غبار ایفا می‌کند. از طرفی دیگر با توجه به این که بار الکتریکی متوسط هر نانوذره بین  $10^3$  تا  $10^4$  برابر بار الکترون است، حضور نانوذرات باردار توزیع بار فضایی و همچنین آرایش میدان الکتریکی داخل پلاسمایی و غلاف پلاسمایی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین در پلاسماهای با فشار بالا، نمی‌توان از اثرات یونیزاسیون و برخوردها بر روی حالت تخلیه الکتریکی صرف نظر کرد. هدف از این مطالعه شبیه سازی نهشت کنترل شده و انتخابی شار یون‌ها و نانوذرات باردار روی سطح یک زیرلایه شامل آرایه‌ای از نانوتیوب‌ها در یک پلاسمای القابی جفت شده (ICP) در دمای پایین و چگالی بالا است. روش مورد استفاده برای این کار، حل عددی معادلات سیالی توصیف کننده دینامیک الکترون‌ها، یون‌ها و نانوذرات است. این معادلات شامل معادلات پیوستگی و ممتومن برای این سه گونه،

پیشرفت‌های اخیر در علم نانو، اهمیت نانوساختارهای صفر، یک و چند بعدی را هم از نقطه نظر تحقیقات بنیادی فیزیک و هم از لحاظ کاربردهای صنعتی به اثبات رسانده است. به عنوان مثال، نانوتیوب‌ها برای ذخیره هیدروژن و کاربردهای اپتیکی، میکروالکترونی و پزشکی، نانوذیواره‌ها و نانونوارها در کاربردهای موج بر، نانومیله‌ها به عنوان سنسورهای گازی، تنها نمونه‌هایی از کاربردهای بسیار وسیع نانوساختارها در صنعت به شمار می‌آیند. در میان نانوساختارهای مختلف، نانوتیوب‌های کربنی منظم به علت مشخصات مکانیکی، اپتیکی و حرارتی ویژه، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. امروزه نانوتیوب‌های کربنی به راحتی با استفاده از تکنیک نهشت بخار شیمیایی تقویت شده پلاسمایی (PECVD) در محیط پلاسمایی رشد داده می‌شوند. نانوتیوب‌های رشد داده شده با این روش دارای نسبت نمود بالایی بوده و انجام فرآیند پوشش‌دهی بر روی آن‌ها در محیط پلاسمایی امکان‌پذیر است.

روش PECVD دارای مزیت‌های زیادی نسبت به سایر روش‌های تولید نانوتیوب‌های کربنی است [۷-۱]. به عنوان مثال در روش نهشت بخار شیمیایی (CVD)، معمولاً لازم است که زیر لایه را به اندازه کافی گرم کرد تا شرایط ذوب کاتالیزور فلزی فراهم شده و تبدیل به نانوذرات کوچکتر شود که این امر در زیرلایه‌ها یا مواد حساس به دما باعث بروز مشکلات اساسی شده و ممکن است حتی منجر به ذوب بسیاری از قطعات و اتصالات الکترونیکی در صنعت میکروالکترونیک شود. اما در روش PECVD، تجزیه ماده خام به طور عمده به وسیله برخوردهای الکترون‌های پر انرژی تولید شده در پلاسمای سرد غیر تعادلی انجام می‌شود. اغلب در این روش از یک سطح زیرلایه طرح دار برای رشد نانوتیوب‌های به طور عمودی تراز شده استفاده می‌شود. از طرف دیگر، نانوتیوب‌هایی که با استفاده از روش‌هایی مانند CVD رشد داده می‌شوند، در بیش تر موارد نامنظم و در جهت‌های تصادفی نسبت به زیرلایه جامد قرار می‌گیرند. در حالی که برای استفاده از نانوساختارها در توسعه گسیلندهای

عددی را ارایه نموده و این نتایج را با نتایج کارهای تجربی انجام یافته در این زمینه مقایسه می‌نماید. در نهایت در بخش<sup>۴</sup> نتایج به دست آمده جمع‌بندی شده و به طور اجمالی مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین پیشنهادهایی برای توسعه آتی این کار ارایه می‌شوند.

### تئوری و مدل شبیه‌سازی

برای شبیه‌سازی رشد نانوتیوب‌ها در محیط پلاسمایی از یک مدل دو بعدی (صفحه  $x-z$ ) استفاده می‌کنیم، بنحوی که طول سیستم در راستای  $z$  نامتناهی فرض می‌شود. مرز غلاف و پلاسما در  $z=0$  و سطح زیرلایه در  $z=L$  واقع شده است. زیرلایه شامل یک آرایه دوبعدی پیش ساخته از نانوتیوب‌هایی به ارتفاع  $a$ ، عرض  $w$  و دوره تناوب  $d$  می‌باشد، که فاصله داخلی بین نانوتیوب‌ها با  $b$  نمایش داده می‌شود. سطح زیرلایه و نانوتیوب‌ها به یک پتانسیل منفی بایاس شده است، (شکل ۱).

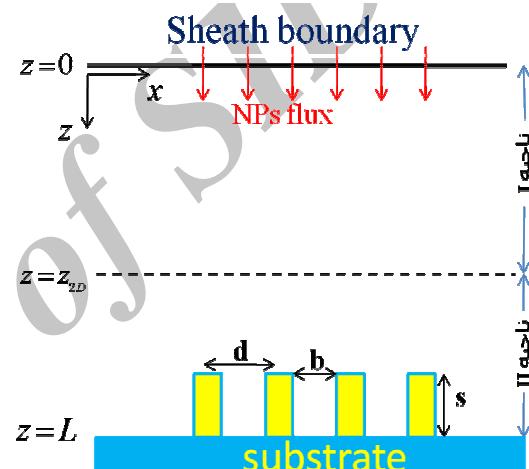
محدوده شبیه‌سازی به دو ناحیه تقسیم می‌شود: یک ناحیه یک بعدی که شامل فاصله بین لبه غلاف تا نزدیکی نانوساختارها است. یعنی ناحیه‌ای که در آن اثر میدان عرضی ناشی از نانوساختارها بسیار ناچیز است. ناحیه دوم که در آن تاثیر میدان الکتریکی سطح نانوساختار روی دینامیک ذرات قابل توجه است و برای توصیف حرکت یون‌ها و ذرات غبار و محاسبه شارهای میکروسکوپیکی بروزی سطح زیرلایه، معادلات سیالی باید به شکل دوبعدی در این ناحیه حل شوند. تعیین این شرایط به طور آزمایشگاهی با ایجاد اختلاف پتانسیل  $V$  بین سطح زیرلایه و لبه بالایی شبکه دو بعدی  $(z, z_{2D})$ ، به آسانی میسر می‌شود [۱۵]. در این حالت مرز بین ناحیه I و II ( $z = z_{2D}$ ) تقریباً چند صد میکرومتر بالاتر از سطح زیرلایه قرار می‌گیرد. بنابراین برای صحت و دقت مدل چند شبکه‌ای به کاربرده شده در شبیه‌سازی، لازم است تا نامساوی  $d, s << L - z_{2D}$  در مورد ابعاد غلاف و آرایه میکروساختار برقرار باشد. پارامترهای پلاسما و آرایه میکروساختار به کار برده شده در شبیه‌سازی در جدول (۱) خلاصه شده است.

معادلات باردار شدن ذرات غبار و معادله پواسون برای محاسبه میدان الکتریکی است. برای حل این مجموعه معادلات، از ترکیب روش‌های رونگ کوتای مرتبه چهارم و مک کورمک استفاده می‌شود. روش رونگ کوتا معمولاً برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیلی با مشتقات معمولی استفاده می‌شود و دلیل انتخاب آن سادگی و سرعت بالای این روش است. از طرف دیگر روش مک کورمک یک روش بسیار ساده برای حل دوبعدی معادلات سیالی در سیالات فراصوتی است. در مطالعه حاضر، ساختار میدان الکتریکی در نزدیکی سطح میکروساختار دارای وابستگی فضایی دوبعدی است، و از آن جایی که یون‌ها و نانوذرات با چندین برابر سرعت صوت وارد غلاف پلاسمایی می‌شوند، روش مک کورمک بهترین و شناخته شده‌ترین روش برای حل معادلات سیالی پلاسما در این شرایط است. برای وضوح بیشتر نتایج عددی ابعاد نانوتیوب‌ها در این شبیه‌سازی در محدوده میکرومتر انتخاب شده است و نتایج به دست آمده به صورت رضایت‌بخشی در ابعاد نانو هم معتبر است. معادلات سیالی برای نانوذرات باردار شامل اثرات نیروهای الکتریکی، گرانش، کشش یونی و ترموفورتیک است. در معادلات الکترون‌ها و یون‌ها اثرات یونیزاسیون، برخورد با اتم‌های خشی و گردایان فشار در نظر گرفته شده و باز نانوذرات به صورت خودسازگار در معادله پواسون منظور می‌شود. بعد از حل معادلات به روش عددی، اثر تغییر پارامترهای تخلیه الکتریکی و خصوصیات میکروساختار روی نهشت گزینشی نانوتیوب‌ها بررسی می‌شوند. پلاسمای مورد بررسی برای تولید نانوساختارهای کربنی کریستالیزه، مخلوطی از  $\text{CH}_4$ ,  $\text{H}_2$  و گاز بی‌اثر آرگون است [۱۷]. از این‌رو، در این شبیه‌سازی پلاسما شامل یون‌های مثبت  $\text{Ar}^+$ ، به عنوان گونه تعیین کننده ساختار غلاف، و یون  $\text{CH}_3^+$ . به عنوان گونه‌ای که در فرآیند رشد شرکت می‌کند، می‌باشد.

این مقاله شامل چهار بخش است. در بخش ۲، تئوری غلاف پلاسمایی، معادلات حاکم بر دینامیک گونه‌های مختلف ذرات پلاسما، و روش عددی مورد استفاده برای حل این معادلات، توضیح داده می‌شود. بخش ۳، نتایج حاصل از شبیه‌سازی

ذرات در طی عبور از پیش غلاف کسب می‌کنند وابسته است زیرا برای رسیدن این ذرات به نزدیکی نانوساختارها لازم است که انرژی آن‌ها در لبه غلاف به حدی باشد که بتوانند به نقطه تغییر علامت بار برسند. در غیر این صورت قبل از رسیدن به این نقطه، توسط میدان الکتریکی ناشی از پتانسیل منفی زیرلایه برگشت داده می‌شوند. به همین دلیل از مقادیر بزرگی از سرعت نرمالیزه نانوذرات در لبه غلاف به عنوان شرط مزدی برای حل معادلات استفاده می‌شود. این تغییر علامت بار نانوذرات در نقطه‌ای درون غلاف رخ می‌دهد، که بار حاصل از مجموع جریان‌های یونی و الکترونی صفر است. شرط مزدی برای حل معادلات استفاده می‌شود. این تغییر علامت بار نانو ذرات در نقطه‌ای درون غلاف رخ می‌دهد، که بار حاصل از مجموع جریان‌های یونی و الکترونی صفر است. در معادلات سیالی یون و الکترون، اثرات یونیزاسیون و برخورد ذرات پلاسما با ختشی‌ها در نظر گرفته می‌شوند، ولی از جملات مربوط به برخورد ذرات پلاسما با یکدیگر صرف نظر می‌شود. نیروی کل وارد بر نانو ذرات غبار تولید شده در پلاسما، شامل نیروی‌های الکترواستاتیکی، کشش یونی، کشش ختشی‌ها و ترموفورتیک است.

چون سرعت حرارتی الکترون‌ها بسیار بیشتر از یون‌ها است، تعداد الکترون‌هایی که برروی نانوذرات جمع می‌شوند بسیار بیشتر از یون‌ها است، لذا در توده پلاسما در حالت عادی بار نانوذرات منفی است. ولی در غلاف پلاسمایی به علت کمبود الکترون و چگالی بالای یون‌ها، نانوذرات می‌توانند در حین حرکت از لبه غلاف به سمت زیرلایه تغییر علامت دهند و بازشان مثبت گردند. در مرجع [۱۵] نشان داد شده است که شار فرودی نانوذرات برروی زیرلایه به مقدار انرژی که این



شکل ۱. هندسه شبیه‌سازی

جدول ۱. پارامترهای استفاده شده در شبیه‌سازی [۱۵]

مقدار	نماد	پارامتر
$10^9 - 10^{10} \text{ cm}^{-3}$	$n_{e0}$	چگالی الکترونی
39 amu(Ar)	$m_i \approx m_n$	جرم یونی و ختشی‌ها
1 eV	$T_e$	دماهی الکترونی
$10^{15} \text{ cm}^{-3}$	$n_n$	چگالی ختشی‌ها
20 nm	$r_d$	شعاع نانوذرات
-8 to -11 V	$\phi_s$	پتانسیل زیرلایه
1-4 $\mu\text{m}$	$s$	ارتفاع میکروساختار
30-60 $\mu\text{m}$	$b$	فاصله میانی نانوتوب‌ها
50-120 $\mu\text{m}$	$d$	پریود میکروطرح
750 $\mu\text{m}$	$l$	طول زیرلایه

تفاوت که برای آنها گرادیان فشاری در نظر گرفته نمی‌شود و جملات مربوط به چشمی و چاهک نانوذرات صفر می‌باشد. پتانسیل الکترواستاتیکی در نواحی نزدیک زیرلایه ( $z < z_{2D}$ )، از حل عددی معادله پواسون دو بعدی همراه با معادلات فوق به دست می‌آید:

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} + \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0 \quad (10)$$

$$4\pi e \left[ -n_e(x, z) + f n_i(x, z) + (1-f) \frac{Q_d}{Q_{d0}} n_d(x, z) \right].$$

در معادلات بالا  $m_j$ ،  $n_j$  و  $V_j$ ، به ترتیب جرم، چگالی تعداد و سرعت برداری ذره نوع  $j$  ام است،  $E_x$  و  $E_z$  به ترتیب مؤلفه  $x$  و  $z$  میدان الکتریکی غلاف،  $f$  نسبت چگالی یونی به الکترونی در لبه غلاف، و  $Q_d$  بار ذرات غبار می‌باشد.  $v_{jn}$  نیز به ترتیب فرکانس یونیزاسیون و فرکانس برخورد ذرات پلاسما با خشی‌ها می‌باشد. در معادله ممتومن ذرات غبار، نیروی‌های کشش یونی ( $F_{di}$ )، کشش خشی ( $F_{dn}$ ) و ترموفورتیک ( $F_{th}$ )، تنها در راستای  $z$  بر ذرات وارد می‌شوند، که اولی به سمت زیرلایه و دو نیروی دیگر به سوی لبه غلاف به نانوذرات وارد می‌شوند [۲۱].

معادلات بالا به وسیله روابط زیر بهنجار می‌شوند [۱۹]:

$$Z = z / \lambda_{De}, \quad Q = eq_{np} / r_{np} T_e, \quad \Phi = \frac{e\phi}{T_e}, \quad (11)$$

$$u_{np} = v_{np} / c_{ds}, \quad u_{i,e} = v_{i,e} / c_{is}, \quad N_j = n_j / n_{0,j},$$

$$\bar{v}_{en} = \frac{m_e V_{en}}{m_i \omega_{pi}}, \quad \bar{v}_{in} = \frac{V_{in}}{\omega_{pi}}, \quad \bar{v}_I = \frac{V_I}{\omega_{pi}},$$

برای حل معادلات از شرایط مرزی زیر در لبه غلاف بهره می‌گیریم:

$$u_{npz} = 4.5, \quad u_{iz} = 1.5, \quad u_{ez} = 0.001,$$

$$u_{npx} = u_{ix} = u_{ex} = 0.0, \quad u_{npy} = u_{iy} = u_{ey} = 0.0, \quad (12)$$

از تئوری حرکت مداری محدود برای محاسبه بار جمع شده در سطح نانوذرات کروی استفاده می‌شود [۱۸]. بدین ترتیب شکل کلی معادلات حاکم برای حالت ایستا به صورت زیر است [۲۰ و ۲۱]:

$$\nabla \cdot (n_d \mathbf{v}_d) = 0, \quad (1)$$

$$\nabla \cdot (n_j \mathbf{v}_j) = \gamma_{in} n_n n_e, \quad j = i, e \quad (2)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (n_d v_{dx}^2) + \frac{\partial}{\partial z} (n_d v_{dx} v_{dz}) = \frac{Q_d}{m_d} E_x, \quad (3)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (n_d v_{dx} v_{dz}) + \frac{\partial}{\partial z} (n_d v_{dz}^2) =$$

$$\frac{Q_d}{m_d} E_z + m_d g + F_{di} + F_{dn} + F_{th},$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (n_i v_{ix}^2) + \frac{\partial}{\partial z} (n_i v_{iz} v_{ix}) = \frac{e}{m_i} E_x - \frac{\partial P_i}{\partial x} - n_i v_{in} v_{ix}, \quad (5)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (n_i v_{iz} v_{ix}) + \frac{\partial}{\partial z} (n_i v_{iz}^2) = \frac{e}{m_i} E_z - \frac{\partial P_i}{\partial z} - n_i v_{in} v_{iz}, \quad (6)$$

$$0 = -\frac{e}{m_e} E_x - \frac{\partial P_e}{\partial x} - n_e v_{en} v_{ex}, \quad (7)$$

$$0 = -\frac{e}{m_e} E_z - \frac{\partial P_e}{\partial z} - n_e v_{en} v_{ez}. \quad (8)$$

که در آن  $n_j$  چگالی تعداد،  $v_{jx}$  و  $v_{jz}$  مؤلفه‌های  $x$  و  $z$  سرعت جریان مربوط به ذره گونه  $j$  ام می‌باشد. در روابط (۴) و (۵)  $p_j$  بیانگر فشار سیال ذره نوع  $j$  ام است که از معادله حالت گاز ایده آل به صورت زیر پیروی می‌کند:

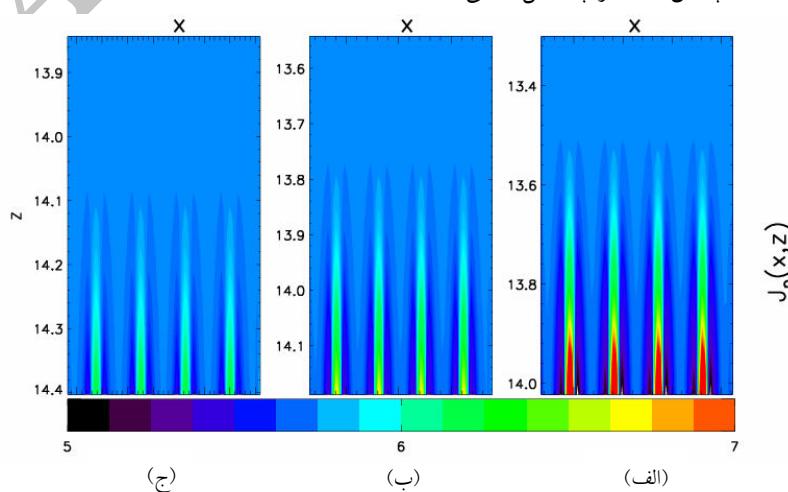
$$P_j = n_j T_j, \quad j = i, e, \quad (9)$$

که در آن  $T_j$  دمای ذره نوع  $j$  ام (یون و الکترون) است و بر حسب واحد انرژی بیان می‌شود. معادلات مربوط به نانوذرات مانند معادلات یون‌ها و الکترون‌ها می‌باشند، با این

نانوساختار روی تمام نقاط شبکه دوبعدی محاسبه شده و در حل معادلات دوبعدی به روش مک کورمک وارد می‌گردد. به این ترتیب کمیت‌های غلاف شامل پتانسیل غلاف، شارهای یونی و نانوذرات بر حسب فاصله بهنجار شده از لبه غلاف ( $Z$ ) و در امتداد آرایه نانوتیوب‌ها ( $X$ ) به صورت خودسازگار و وابسته به هم به دست می‌آیند.

### تحلیل نتایج شبیه‌سازی

در این شبیه‌سازی از یک پلاسمای آرگون با چگالی الکترونی  $n_{e0} = 5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$  استفاده شده است. بنابراین با توجه به شرط شبیه خشی بودن پلاسما و نسبت چگالی یونی به الکترونی  $f = 1.7$ ، چگالی تعداد نانوذرات از مرتبه  $10^7 \text{ cm}^{-3}$  می‌باشد، که شرایط لازم را برای بهره‌گیری از رهیافت سیالی مهیا می‌کند. فرکانس‌های بهنجار یونیزاسیون، پرخورد یون-خشی و الکترون-خشی به ترتیب برابر با  $v_{en} = 0.002$ ،  $v_{in} = 0.01$  و  $v_i = 0.01$  می‌باشند. شکل‌گیری و نهشت نانوذرات بر روی سطح میکروساختار واقع در زیرلایه، به شدت وابسته به پارامترهای تخلیه الکتریکی پلاسمایی مانند چگالی اولیه و دمای الکترونی، و پارامترهای ذرات غبار از قبیل نسبت چگالی یونی به الکترونی و سرعت نانوذرات غبار در مزرع غلاف با پلاسما، است. ما نخست تأثیرات ناشی از تغییر این پارامترها را روی نهشت نانوذرات مورد بررسی قرار می‌دهیم.

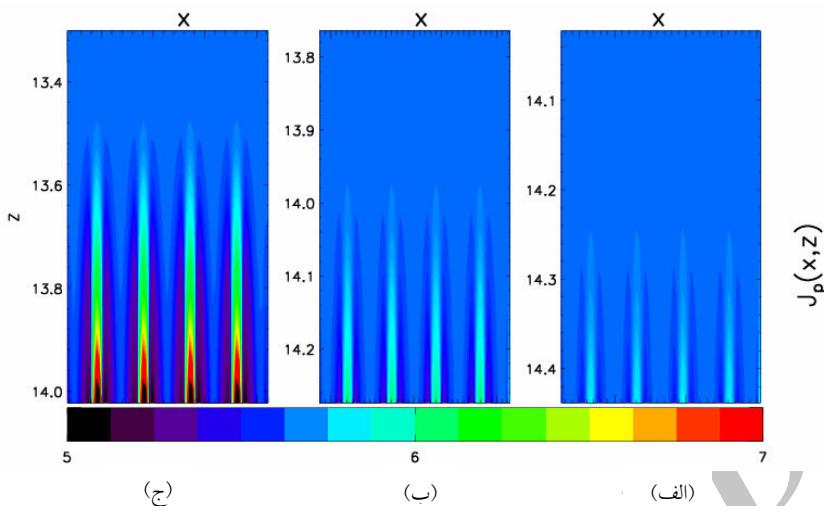


شکل ۲. پریند شار فرودی ذرات پلاسما روی سطح نانوتیوب‌ها به ازای سه مقدار مختلف چگالی الکترونی پلاسما:

$$(a). n_{e0} = 3 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}, (b). n_{e0} = 4 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \text{ و } (c). n_{e0} = 5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_{np,i,e} = 1, \quad \Phi = 0.0, \quad \Phi_s = -11 \text{ V}, \quad d\Phi / dZ = \bar{V}_{in}.$$

برای شبیه‌سازی پلاسما در ناحیه ۱، ابتدا فرم یک بعدی معادلات (۸-۱) را به کمک معادلات (۱۱) بهنجار می‌کنیم [۱۹]. سپس معادلات حاصل را با در نظر گرفتن شرایط مرزی (۱۲)، به روش رونگ-کوتای مرتبه چهارم حل می‌کنیم. در ناحیه ۲، شکل دوبعدی معادلات به روش پیش‌بینی و تصحیح مکرور مکرور حل می‌شوند [۲۰]. در این روش عددی، مقادیر روی یک مرز افقی (در اینجا لبه غلاف) معلوم می‌باشند و با جداسازی معادلات در دو مرحله پیش‌بینی و تصحیح، مقادیر در گام بعدی در راستای عمود به دست می‌آیند. شرطی برای مقادیر کمیت‌ها روی زیرلایه (نهایی ناحیه شبیه‌سازی) در نظر گرفته می‌شود و حل تا جایی پیش می‌رود که مقادیر به دست آمده این شرط را ارضاء کنند. از حل معادله لاپلاس دوبعدی به روش تکرار SOR اثر میدان نانوساختار در نزدیکی سطح زیرلایه (ناحیه ۲)، به دست می‌آید. در این روش برای مرزهای عمودی ناحیه دوبعدی (۰  $\leq X \leq X_{max}$ ) از مقادیر پتانسیل مربوط به حل یک بعدی معادله پواسون استفاده می‌کنیم. همچنین برای مرزهای افقی شامل لبه غلاف و زیرلایه، به ترتیب مقادیر اولیه پتانسیل در لبه غلاف و پتانسیل روی سطح نانوساختار را در نظر می‌گیریم. با در نظر گرفتن این مقادیر برای مرزها و مقادیر حدسی اولیه برای نقاط داخل شبکه دوبعدی، با اجرای الگوریتم تکرار روی معادله لاپلاس، مقادیر پتانسیل ناشی از



شکل ۳. تغییرات شار فرودی ذرات غبار روی سطح میکروساختار به ازای سه مقدار مختلف دمای الکترونی: (الف)  $3 \text{ eV}$ ، (ب)  $2 \text{ eV}$ ، و (ج)  $1 \text{ eV}$ .

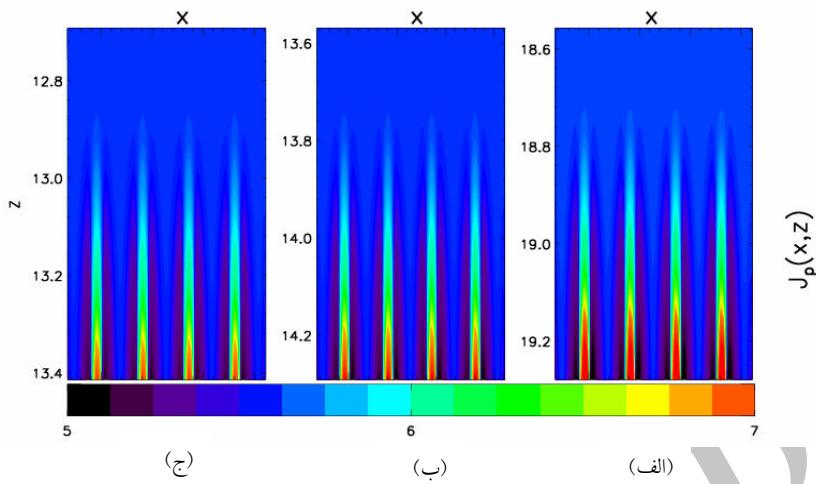
توسط نانوتیوب‌ها می‌گردد. بر طبق رابطه شبه خنثائیت، افزایش نسبت چگالی یونی به الکترونی، بینگر افزایش چگالی نانوذرات (غبار) در لبه غلاف است. افزایش چگالی تعداد غبار باعث می‌شود که تعداد الکترون‌های جذب شده توسط هر ذره غبار کاهش یافته و بنابراین بار منفی ذره کاهش پیدا کند. با کاهش بار منفی غبار، این ذرات سریع‌تر تغییر علامت داده و توسط میدان ناشی از سطح نانوتیوب‌ها منحرف می‌شوند. این امر موجب نهشت مؤثرتر نانوذرات بر روی سطح نانوتیوب‌ها می‌شود.

اکنون اثر سرعت نانوذرات در لبه غلاف یا عدد ماخ نانوذرات را بر روی رشد نانوساختارها مطالعه می‌کنیم. شکل ۵ شار فرودی بر روی زیرلایه را به ازای اعداد ماخ مختلف نشان می‌دهد. در این شکل به وضوح مشاهده می‌شود، وقتی ذرات انرژی بیشتری در پیش غلاف کسب می‌کنند پهنه‌ی غلاف کاهش می‌یابد، و تمرکز شار فرودی بر روی سطح نانوساختارها در هر ارتفاعی بیشتر می‌شود. جالب است که به ازای یک تغییر کوچک در پهنه‌ی غلاف، انحراف ذرات از مسیر اولیه زیاد است (شکل ۵-الف). برای توجیه این نتایج می‌توان گفت که افزایش سرعت اولیه نانوذرات موجب افزایش بار مثبت نانوذرات غبار در نزدیکی زیرلایه می‌شود، علاوه بر این، چگالی تعداد ذرات غبار رسیده به دیواره نیز افزایش می‌یابد. این دو اثر با هم منجر به افزایش شار نانو-

فرآیند رشد سریع‌تر صورت می‌گیرد. این نتیجه با مشاهدات تجربی مرجع [۲۲] در مورد رشد نانومخروط‌های کربنی تک کریستالی در محیط پلاسمایی سازگاری کامل دارد. در شکل ۳، تأثیر دمای الکترونی بر نهشت ذرات پلاسمایی نشان داده شده است. همان طور که می‌بینیم افزایش دمای الکترونی سبب کاهش قابل توجهی در نهشت ذرات غبار روی سطح نانوتیوب‌ها شده است. با افزایش دمای الکترونی بار کل ذرات غبار کاهش می‌یابد و در نتیجه انحراف آنها توسط میدان الکتریکی نانوتیوب‌ها کاهش پیدا می‌کند، بنابراین شار ذرات پلاسمایی روی سطح نانوتیوب‌ها کاهش می‌یابد.

از طرفی دیگر ثابت شده است که در رشد نانوساختارها به وسیله پلاسمای، تخلیه‌های القایی که دارای چگالی پلاسمای بالا و دما و فشار کم هستند بر تخلیه‌های خازنی که دارای چگالی کم و دما و فشار بالا می‌باشند، برتری دارند [۲۳ و ۲۴]. بنابراین نتیجه ارائه شده در بالا در مورد کاهش شار نهشت یافته با افزایش دمای الکترونی، مطابقت کیفی خوبی با یافته‌های آزمایشگاهی در زمینه نانوساخت نانوساختار پلاسمایی دارد.

در پلاسماهای غباری یکی از پارامترهای مؤثر در فرآیند رشد میکروساختارها، نسبت چگالی یونی به الکترونی در لبه غلاف ( $f = n_{i0}/n_{e0}$ ) است. شکل ۴ تأثیر این پارامتر را روی نهشت نانوذرات نشان می‌دهد. به وضوح دیده می‌شود که افزایش پارامتر  $f$  منجر به کانونی شدن مؤثرتر شار فرودی



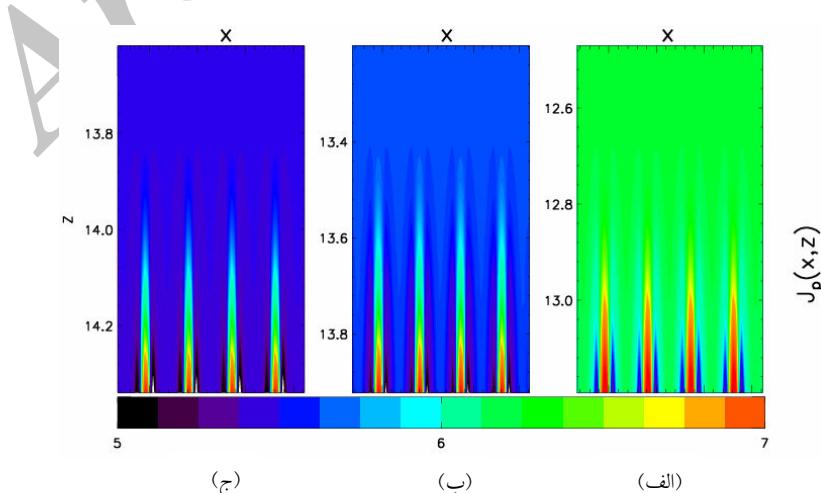
شکل ۴. تغییرات شار فرودی ذرات غبار روی سطح میکروساختار به ازای سه مقدار مختلف دمای الکترونی: (الف) ۳ eV، (ب) ۲ eV، و (ج) ۱ eV

شکل ۶ تأثیر ارتفاع نانوتیوب‌ها را بر شار فرودی روی سطح آنها نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که با افزایش ارتفاع، شار بیشتری روی نانوتیوب‌ها نهشت می‌یابد. در واقع با افزایش ارتفاع نانوتیوب‌ها، چگالی بار سطحی نانوتیوب‌ها افزایش یافته و میدان الکتریکی ناشی از آن‌ها قوی‌تر می‌شود. در نتیجه انحراف شار نانو ذرات توسط سطح نانوتیوب‌ها بهتر صورت می‌گیرد.

دوره تناوب آرایه نانوتیوب‌ها یکی دیگر از پارامترهای مؤثری است که روی توزیع شار میکروسکوپیکی نانوذرات تأثیرگذار است.

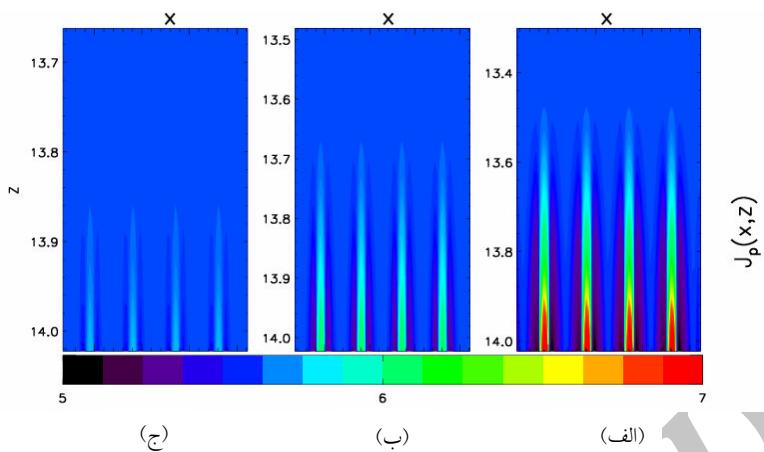
ذرات و انحراف بیشتر آن‌ها به سمت نانوساختارها شده و در نتیجه شار نهشت یافته روی سطح نانوتیوب‌ها افزایش می‌یابد. نتایج فوق با نتایج عددی و تجربی گزارش شده در مرجع [۱۷] کاملاً همخوانی دارد.

رشد نانوتیوب‌های کربنی عمودی تراز شده بر روی زیرلایه رسانا، علاوه بر پارامترهای پلاسما و نانوذرات که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، به خصوصیات آرایه‌ای که نانوتیوب‌ها روی آن رشد داده می‌شوند نیز وابسته است. این ویژگی‌ها شامل ارتفاع و دوره تناوب در یک آرایه از پیش تعیین شده می‌باشند. در ادامه تأثیر این پارامترها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.



شکل ۵. پرینت تغییرات شار فرودی ذرات پلاسما به ازای سه مقدار مختلف سرعت اولیه بهنجار شده نانوذرات غبار

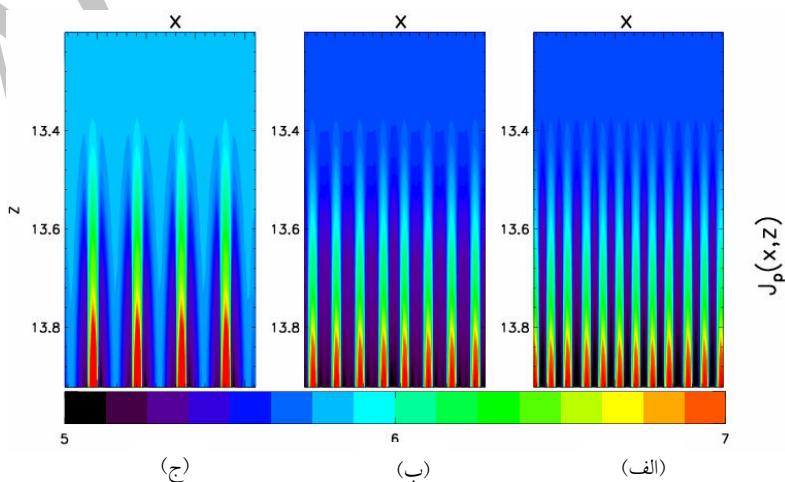
در لبه غلاف: (الف)  $M_d = 4.5$ ، (ب)  $M_d = 5.0$  و (ج)  $M_d = 5.5$



شکل ۶. پرینت شار ذرات روی سطح میکروساختار برای سه ارتفاع مختلف نانوتیوب‌ها: (الف)  $s = 4 \mu\text{m}$ ، (ب)  $s = 3 \mu\text{m}$ ، و (ج)  $s = 2 \mu\text{m}$ .

می‌آیند در حالی که این پتانسیل در مرجع [۱۵] از روابط تحلیلی تقریبی محاسبه می‌شود. دوم این که در این کار بار نانوذرات به صورت خودسازگار در معادله پواسون وارد می‌شود در حالی که در مرجع [۱۵] از نقش نانوذرات در تولید میدان الکتریکی غلاف صرف نظر می‌شود. در نهایت این که در کار حاضر اثر جمع آوری ذرات پلاسمما به وسیله ذرات غبار، به عنوان یک جمله چاهک در معادلات پیوستگی یون‌ها والکترون‌ها وارد می‌شود، ولی در مرجع [۱۵] از این اثر نیز صرف نظر شده است. بنابراین مطالعه ارایه شده در اینجا نسبت به مرجع [۱۵] دارای سازگاری بیشتری بوده به موقعیت فیزیکی آزمایشگاهی نزدیکتر است.

از شکل ۷ مشاهده می‌شود که با افزایش دوره تناوب (شکل ۷-(ج))، همپوشانی میدان ناشی از هر نانوتیوب کاهش یافته و گرادیان عرضی حاصل از هر یک از آن‌ها افزایش می‌یابد، بنابراین توانایی هر نانوتیوب در متمرکز کردن شار ذرات بر روی سطح خود افزایش پیدا می‌کند، که این امر موجب تسريع در رشد نانوتیوب‌ها خواهد شد. نتایج یاد شده در بالا سازگاری کیفی خوبی با نتایج عددی مرجع [۱۵] دارد. اما نتایج ما از چندین جهت بر نتایج مرجع [۱۵] برتری دارد. نخست این که در اینجا پتانسیل مربوط به غلاف الکتریکی چه در ناحیه یکبعدی و چه در ناحیه دوبعدی به صورت خودسازگار از حل عددی معادلات سیالی پلاسمما به دست



شکل ۷. پرینت تغییرات شار فرودی بر روی سطح نانوتیوب‌ها برای سه دوره تناوب مختلف: (الف)  $d = 50 \mu\text{m}$ ، (ب)  $d = 80 \mu\text{m}$  و (ج)  $d = 120 \mu\text{m}$ . ولتاژ زیرلایه  $11\text{V}$  می‌باشد.

### نتیجه گیری

نهشت مؤثرتر بر روی میکرو طرح می شود. بنابراین برای رسیدن به آهنگ های رشد بالا باید این ذرات قبل از رسیدن به لبه غلاف توسط اختلاف پتانسیل مناسبی در توده اصلی پلاسما شتاب داده شوند که برای این کار می توان از اعمال یک میدان خارجی بین مرکز پلاسما و لبه غلاف استفاده کرد.

۴- با افزایش ارتفاع نانوتیوبها، چگالی بار سطحی نانوتیوبها افزایش یافته و شار بیشتری روی آنها نهشت می کند.

۵- با افزایش دوره تناوب آرایه نانوتیوبها، کانونی شدن شار ذرات توسط هر نانوتیوب بهتر صورت می گیرد و نانوتیوب هایی با نسبت نمود بالا تولید می شوند که برای کاربردهای نشر الکترونی در صفحات نمایشگر تخت از اهمیت بالایی برخوردار است.

لازم به تأکید است که نتایج به دست آمده در این کار کاملاً کلی بوده و قابل کاربرد برای گستره وسیعی از فرآیندهای نانوساخت پلاسمایی دمای پایین، فرآوری مواد و فرآیندهای اصلاح سطح می باشند. به عنوان پیشنهاد برای مطالعات آتی، می توان به جای شبیه سازی غلاف پلاسمایی به شبیه سازی کل تخلیه الکتریکی پرداخت که هم شامل غلاف پلاسمایی و هم توده اصلی پلاسماست. اگرچه این کار به توان محاسباتی زیادی نیاز دارد ولی نتایج به دست آمده از این روش بسیار بیشتر به نتایج واقعی آزمایشگاهی نزدیک خواهد بود. از طرفی دیگر، در یک مطالعه کاملاً خودسازگار باید فرآیندهای شبیه سازی ذرات پلاسما و رادیکال های آزاد در محیط پلاسمایی و بر روی سطح در نظر گرفته شوند. این امر برای رسیدن تخلیه الکتریکی به حالت پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است و چگالی گونه های مختلف را در داخل پلاسما تعیین می کند که برای محاسبه شار فرودی بر روی میکرو طرح ضروری است.

در این کار با استفاده از شبیه سازی سیالی خودسازگار دوبعدی، اثرات ناشی از تغییرات پارامترهای پلاسما، مشخصات نانوذرات، و خصوصیات هندسی میکرو طرح بر فرآیند نهشت پلاسمایی نانوتیوبها مورد بررسی قرار گرفتند. ویژگی کار انجام یافته در مقایسه با سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، در نظر گرفتن اثر نانوذرات در ساختار غلاف، بررسی دینامیک حرکت یون ها و نانوذرات در حضور نیروهای مختلف حاکم بر تخلیه الکتریکی و بررسی فرآیند رشد با لحاظ کردن اثر یونیزاسیون و برخوردهای ذرات پلاسما با اتم های خشی است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که برای بهینه سازی فرآیند رشد نانوساختارها در یک محیط پلاسمایی باید از یک پلاسمایی با چگالی بالا و دمای پایین و نانوذرات غبار با سرعت فرودی بالا و همچنین هندسه میکرو طرح با دوره تناوب نسبتاً بزرگ استفاده نمود، تا شار فرودی مطلوب با انرژی برخورده مناسب بر روی زیر لایه طرح دار حاصل شود. نکات حاصل از این مطالعه را می توان به صورت زیر جمع بندی کرد:

۱- مولفه افقی میدان الکتریکی، عمود بر سطح نانوتیوب ها، منجر به کانونی شدن شار نانوذرات بر روی میکرو طرح می شود، که این اثر منجر به تولید نانوساختارهای با نسبت نمود بالا می گردد.

۲- در پلاسمایی با چگالی الکترونی بالا، ذرات غبار بار الکتریکی بیشتری کسب می کنند. بنابراین چگالی های الکترونی بالا برای دستیابی به کانونی شدگی مؤثر و در نتیجه آهنگ رشد بالا بسیار مطلوب می باشند. از طرفی دیگر، افزایش دمای الکترونی باعث کاهش شار فرودی پلاسما و نانوذرات می شود. این اثرات دلیل انتخاب راکتورهای جفت شده القایی برای نانوساخت پلاسمایی است، چون این راکتورها پلاسماهایی با چگالی بالا، دمای پایین و غلاف هایی با ضخامت کم تولید می کنند که برای تولید نانوساختارها مناسب است.

۳- افزایش عدد ماخ و چگالی تعداد ذرات غبار موجب افزایش شار فرودی ذرات پلاسما و نانوذرات و در نتیجه

### منابع

1. A. Stacey, I. Aharonovich, S. Prawer, and J. E. Butler, *Controlled synthesis of high quality micro/nano-diamonds by microwave plasma chemical vapor deposition*, Diamond Relat. Mater. 18, No.1(2009)51-55.
2. K. Ostrikov, S. Xu, S. Y. Huang, and I. Levchenko, *Nanoscale surface and interface engineering: Why plasma aided*, Surface and Coatings Technology, 202, No.22-23(2008)5314-5318.
3. S. Y. Huang, K. Ostrikov, and S. Xu, *Plasma-enabled growth of ultralong straight, helical, and branched silica photonic nanowires*, Journal of Applied Physics, 104, No.3 (2008)033301-1 – 033301-7.
4. K. Ostrikov, I. Levchenko, S. Xu, S. Y. Huang, Q. J. cheng, J. D. Long, and M. Xu, *Self-assembled low-dimensional nanomaterials via low-temperature plasma processing*, Thin Solid Films, 516, No.16 (2008)6609-6615.
5. A. A. El Mel, E. Gautron, C. H. Choi, B. Angleraud, A. Granier and P. Y. Tessier, *Titanium carbide/carbon composite nanofibers prepared by plasma process*, Nanotechnology, 21, No.43(2010)435603.
6. J. Zheng, R. Yang, L. Xie, J. Qu, Y. Liu and X. Li, *plasma assisted approaches in inorganic nanostructure fabrication*, Advanced Materials, 22, No.13(2010)1451.
7. X. Liwei, W. Jianhua, M. Weidong, W. Jun, and L. Changlin, *Preparation of nanocrystalline diamond films on poly-crystalline diamond thick films by microwave plasma enhanced chemical vapor deposition*, Plasma Science and Technology, 12, No.3(2010)310.
8. K. Ostrikov, *Surface science of plasma exposed surfaces: A challenge for applied plasma science*, Vacuum, 83, No.1(2009)4-10.
9. I. Levchenko, and K. Ostrikov, *Plasma/ion-controlled metal saturation: Enabling simultaneous growth of carbon nanotube/nanocone arrays*, Applied Physics Letters, 92, No.6(2008)063108-1-063108-3.
10. I. Levchenko, K. Ostrikov, D. Mariotti, and A. B. Murphy, *Plasma-controlled metal catalyst saturation and the initial stage of carbon nanostructure array growth*, Journal of Applied Physics, 104, No.7(2008)073308-1 – 073308-8.
11. M. Wolter, I. levchenko, H. Kersten, and K. ostrikov, *hydrogen in plasma nanofabrication: selective control of nanostructure heating and passivation*, Applied Physics Letters, 96, No.13(2010)133105.
12. T. Mizutan, H. Ohnaka, Y. Okigawa, S. kishimoto, and Y. Ohno, *a study of preferential growth of carbon nanotubes with semiconducting behavior growth by plasma enhanced chemical vapor deposition*, Journal of Applied Physics, 105, No.7(2009)073705.
13. M. Mao, and A. Bogaerts, *Investigation the plasma chemistry for the synthesis of carbon nanotubes in inductively coupled plasma enhanced CVD systems: the effect of different gas mixtures*, Journal of Physics D: Applied Physics, 43, No.20(2010)205201.
14. S. Vizireanu, S. D. Stoica, C. Luculescu, L. C. Nistor, B. Mitu, and G. Dinescu, *Plasma techniques for nanostructured carbon materials synthesis. A case study: Carbon nanowall growth by low pressure expanding RF plasma*, Plasma Sources Science and Technology, 19, No.3 (2010)034016.
15. P. P. Rutkevych, K. Ostrikov, and S. Xu; *Two-dimensional simulation of nanoparticle deposition from high-density plasmas on micro structured surface*; Physics of Plasma, 14, No. 4(2007)043502-1 – 043502-9.
16. E. Tam, I. Levchenko, K. Ostrikov, M. Keidar, and S. Xu; *Ion-assisted functional monolayer coating of nanorod arrays in hydrogen plasmas*; Physics of Plasmas, 14, No. 3 (2007)033503-1 – 033503-9.
17. K. Ostrikov and S. Xu, *Plasma Nanoscience: From Basic Concepts and Applications of Deterministic Nanofabrication*, Wiley, Weinheim, (2008).
18. G. Foroutan, H. Mehdipour, and H. Zahed, *Simulation study of the magnetized sheath of a dusty plasma*, Physics of Plasmas, 16, No.1 (2009) 103703.
19. H. Mehdipour, and G. Foroutan, *The magnetized sheath of a dusty plasma with nanosize dust grains*, Physics of Plasmas, 17, No.8 (2010) 083704-1 – 083704-11.
20. J. D. Anderson, Jr. *Computational Fluid Dynamics*, McGraw-Hill (1995) 226-229.

21. P. P. Rutkevych Levchenko, K. Ostrikov, S. Xu, and S. V. Vladimirov, *Thermophoretic control of building units in the plasma-assisted deposition of nanostructured carbon films*, Journal of Applied Physics, 96 No.8 (2004) 4421 – 4428.
22. I. Levchenko, K. Ostrikov, J. D. Long, and S. Xu, *Plasma assisted self-sharpening of platelet-structured single-crystalline carbon nanocones*, Applied Physics Letters, 91, No.11 (2007) 113115-1–113115-3.
23. S. Xu, K. Ostrikov, J. D. Long, and S. Y. Huang, *Integrated plasma-aided nanofabrication facility: Operation, parameters, and assembly of quantum structures and functional nanomaterials*, Vacuum, 80, No.6 (2006) 621-630.
24. K. Ostrikov, and A. B. Murphy, *plasma-aided nanofabrication: Where is the cutting edge?*, Journal of Physics D: Applied Physics, 40 No.8 (2007) 2223-2241.

Archive of SID